**LISTA ZMIAN**

 **Zapytania ofertowe SDM-WS/45 z dnia 5 maja 2021 r.**

**LIST OF CHANGES**

**Request for Proposals SDM-WS/45 of 5th May 2021**

W dniu 11.05.2021 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego.

Zgodnie z listą zmian:

W wersji polskojęzycznej Zapytania Ofertowego

w pkt. 2.3 było:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

**·** 20 profili wgłębnych półprzewodnikowych warstw epitaksjalnych III – V;

· grubość powinna być analizowana do 10 µm;

· analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie międzywierzchni z rozdzielczością wgłębną 1nm;

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj działania | Parametr/Funkcja |
| Analiza grubości | - do 10 µm |
| Analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie międzywierzchni | - charakteryzacja międzywierzchni z rozdzielczością wgłębną 1nm |

jest:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

· 20 profili wgłębnych półprzewodnikowych warstw epitaksjalnych III – V;

· grubość powinna być analizowana do 10 µm;

· analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie międzywierzchni w przedziale pomiarowym 10nm;

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj działania | Parametr/Funkcja |
| Analiza grubości | - do 10 µm; |
| Analiza segregacji atomów matrycowych i zanieczyszczeń w rejonie międzywierzchni | - charakteryzacja międzywierzchni w przedziale pomiarowym 10nm. |

w pkt. 8 było:

**8. Termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **11 maja 2021 r.**
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

jest:

**8. Termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **13 maja 2021 r.**
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

In English version of the Request for proposals:

In point 2.3 there was:

3. Detailed description of the subject of the order:

● 20 depth profiles of III – V semiconductors epi-layers;

● thickness need to be analyzed up to 10 µm;

● analysis of potential segregation of matrix atoms and contaminations at the interfaces with in-depth resolution of 1 nm;

|  |  |
| --- | --- |
| Action type | Parameter/Function |
| Thickness analysis | - up to 10 µm |
| Analysis of potential segregation of matrix atoms and contaminations at the interfaces | - characterization of the interfaces with in-depth resolution of 1nm |

There is:

1. Detailed description of the subject of the order:

● 20 depth profiles of III – V semiconductors epi-layers;

● thickness need to be analyzed up to 10 µm;

● analysis of potential segregation of matrix atoms and contaminations at the interfaces with a measurement interval of the order of 10 nm.

|  |  |
| --- | --- |
| Action type | Parameter/Function |
| Thickness analysis | - up to 10 µm; |
| Analysis of potential segregation of matrix atoms and contaminations at the interfaces | - characterization of the interfaces with a measurement interval of the order of 10 nm. |

There was:

**8 Deadline for submission of bids**

1. The offer should be submitted by:  **11th May, 2021.**

2. The Contractor shall be bound by the submitted offer for a period of at least **60 days**. The bid validity period begins with expiry of the deadline for submitting offers.

There is:

**8. Deadline for submission of bids**

8.1 The offer shall be submitted by:  **13th May, 2021.**

8.2 The Contractor shall be bound by the submitted offer for a period of at least **60 days**. The bid validity period begins with expiry of the deadline for submitting offers.